

仕 様 書

1. 件名

CMP 装置用研磨処理スラリー

2. 研究の概要

2nm 世代以降の最先端ロジック半導体は、Society 5.0 を支えるリアルタイムコンピューティング技術として我が国の産業競争力の核となるとともに、様々な社会課題を解決するための技術基盤として期待されるポスト 5G の実現に必要不可欠である。つくば西事業所スーパークリーンルーム (SCR) では、新たに最先端の微細化プロセスに対応した装置群を追加整備して、ポスト 5G 世代の半導体としてナノシート構造トランジスタの製造技術を開発し、先端半導体関連の研究開発を行う企業等が当該製造技術をプラットフォームとして利用可能なパイロットラインを構築している。

本パイロットラインに令和 5 年度に整備した CMP 装置 (株式会社荏原製作所製、型式 : F-REX300X、資産番号 : 23AA4916) では研磨用にスラリーを使用している。

3. 物品の概要

当該 CMP 装置において、タングステン薄膜の研磨処理を実施するためのスラリーである。

4. 納入物品

・ CMP 装置用研磨処理スラリー

インテグリス社製、型式 ; WIN W8053、容量 : 20L、本数 : 8 本

5. 納入の完了

「4. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

6. 納入期限及び納入場所

納入期限 : 2025 年 4 月 30 日

※準備が整い次第、納入すること。

納入場所 : 国立研究開発法人産業技術総合研究所
先端半導体研究センター

つくばセンター西事業所 7B 棟 SCR または 7A 棟 3001 室
茨城県つくば市小野川 16-1

7. 付帯事項

- (1) 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。
- (2) 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者の指示に従うこと。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。